

# 2021年3月期 第3四半期（2020年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2021年1月28日

内容：

- 第3四半期 連結決算の概要      取締役 専務執行役員      布川 好一
- 事業環境および業績予想      代表取締役社長・CEO      河合 利樹



# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。

一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

# 第3四半期 連結決算の概要

2021年1月28日

布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長



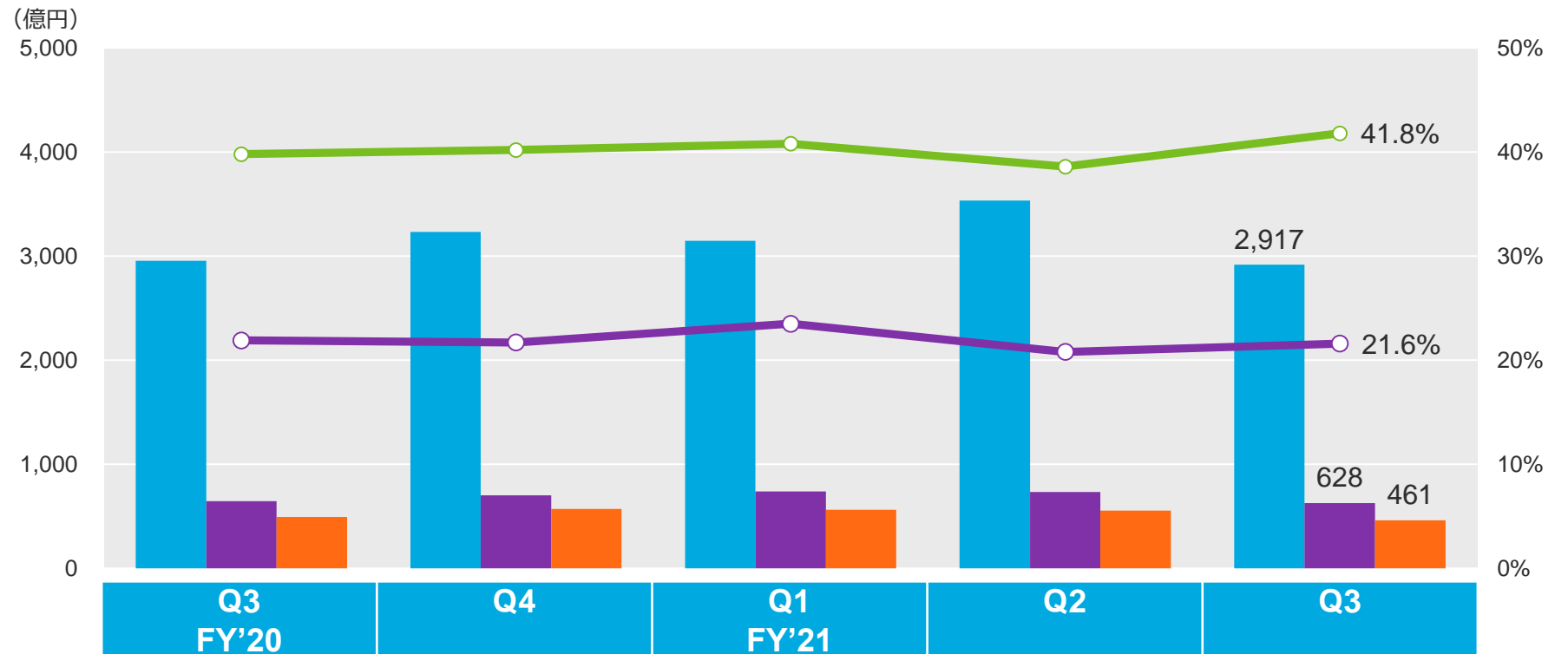
# 損益状況

(億円)

	FY2020		FY2021			対FY2021 Q2 増減
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
売上高	2,954	3,233	3,148	3,533	2,917	-17.4%
SPE	2,820	3,089	3,037	3,316	2,643	-20.3%
FPD	133	143	110	216	273	+26.7%
売上総利益	1,175	1,298	1,284	1,363	1,219	-10.6%
下段：売上総利益率	39.8%	40.2%	40.8%	38.6%	41.8%	+3.2pts
販管費	528	597	546	627	590	-5.9%
営業利益	647	701	738	735	628	-14.6%
下段：営業利益率	21.9%	21.7%	23.5%	20.8%	21.6%	+0.8pts
税金等調整前当期純利益	646	733	746	730	623	-14.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	493	571	564	555	461	-16.9%
研究開発費	298	334	301	362	330	-8.7%
設備投資額	132	117	132	149	88	-40.9%
減価償却費	76	86	71	81	88	+9.3%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

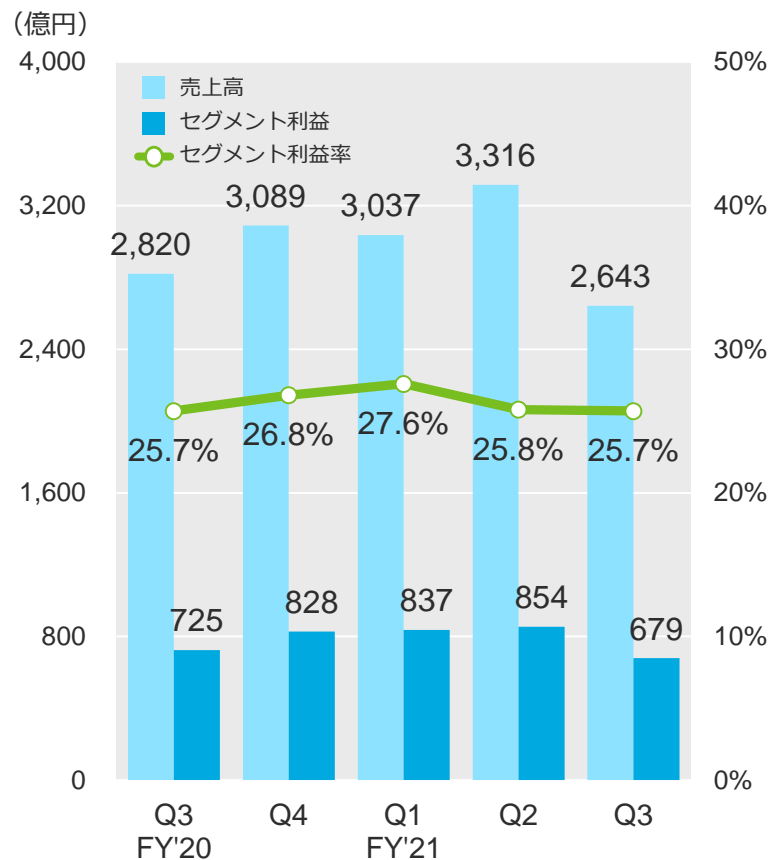
# 損益状況



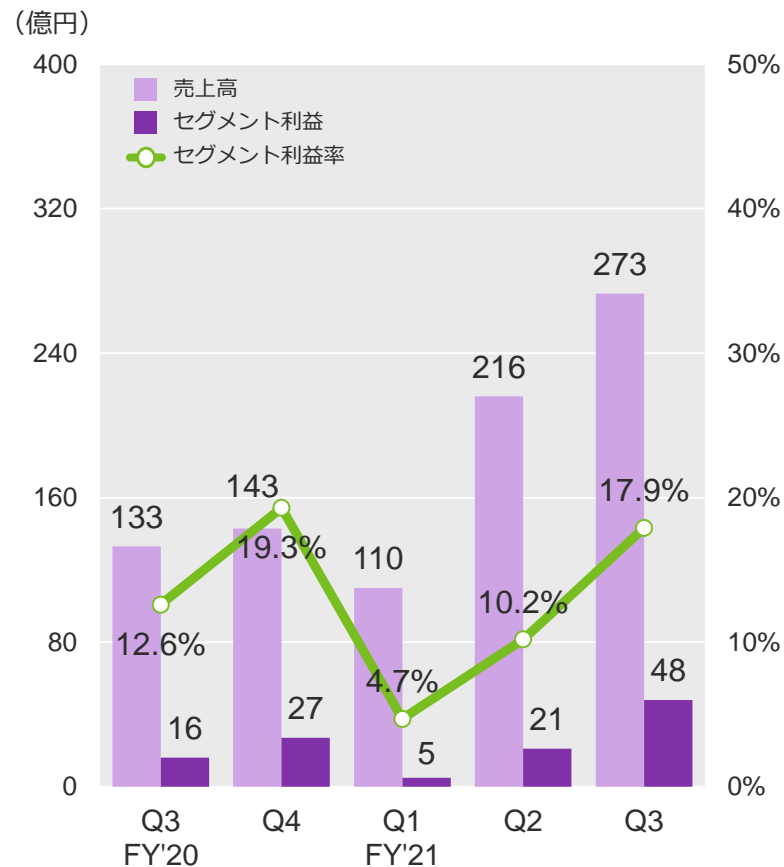
■ 売上高	2,954	3,233	3,148	3,533	2,917
■ 営業利益	647	701	738	735	628
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	493	571	564	555	461
● 売上総利益率	39.8%	40.2%	40.8%	38.6%	41.8%
● 営業利益率	21.9%	21.7%	23.5%	20.8%	21.6%

# セグメント情報

## SPE (半導体製造装置)



## FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



## 売上構成比率

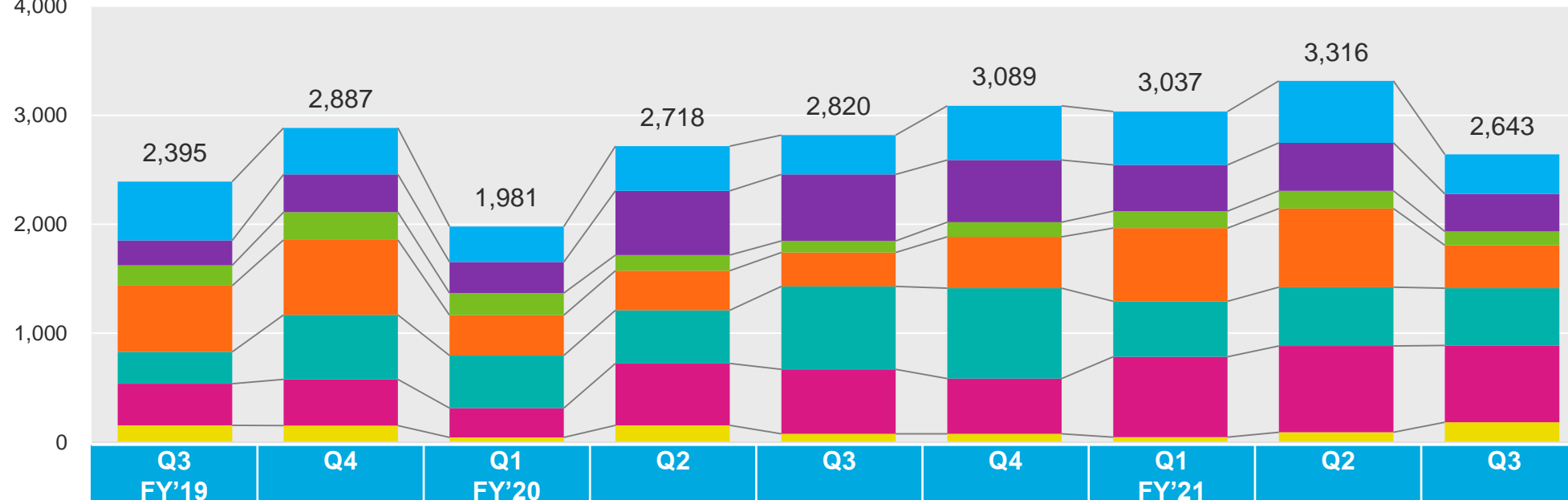


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。



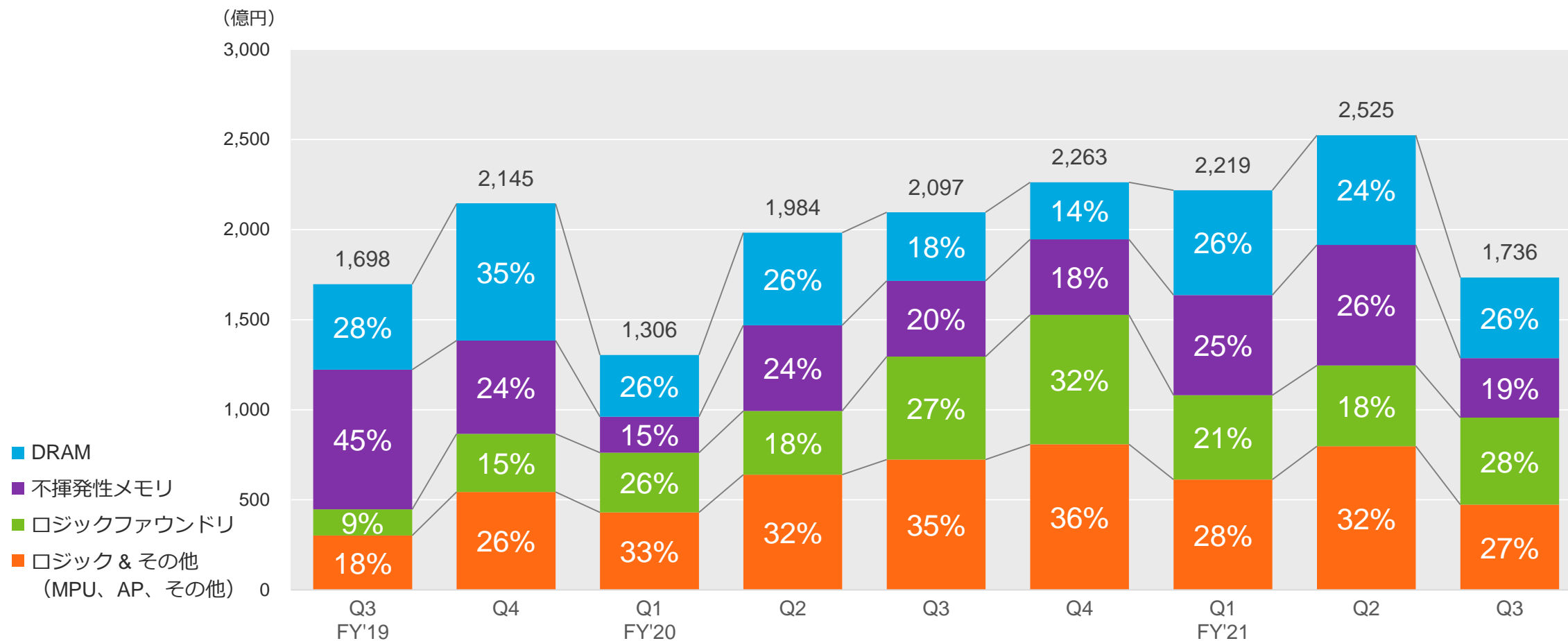
# SPE部門 地域別売上高

(億円)  
4,000



	Q3 FY'19	Q4	Q1 FY'20	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'21	Q2	Q3
日本	540	427	325	410	359	496	491	568	361
北米	227	347	285	588	610	572	423	440	345
欧州	186	253	202	144	108	133	157	163	127
韓国	609	689	369	364	310	471	670	721	393
台湾	293	591	483	487	762	831	509	539	525
中国	380	425	270	568	591	506	739	791	705
東南アジア・他	156	152	44	155	77	77	46	92	184

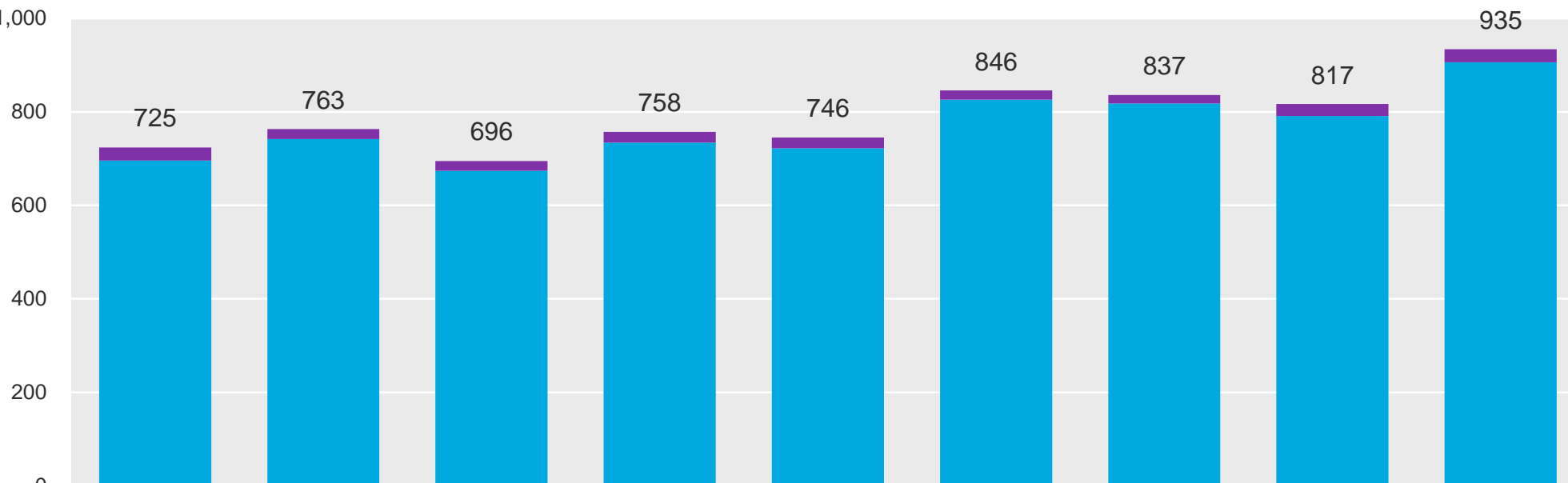
# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比





# フィールドソリューション売上高

(億円)  
1,000

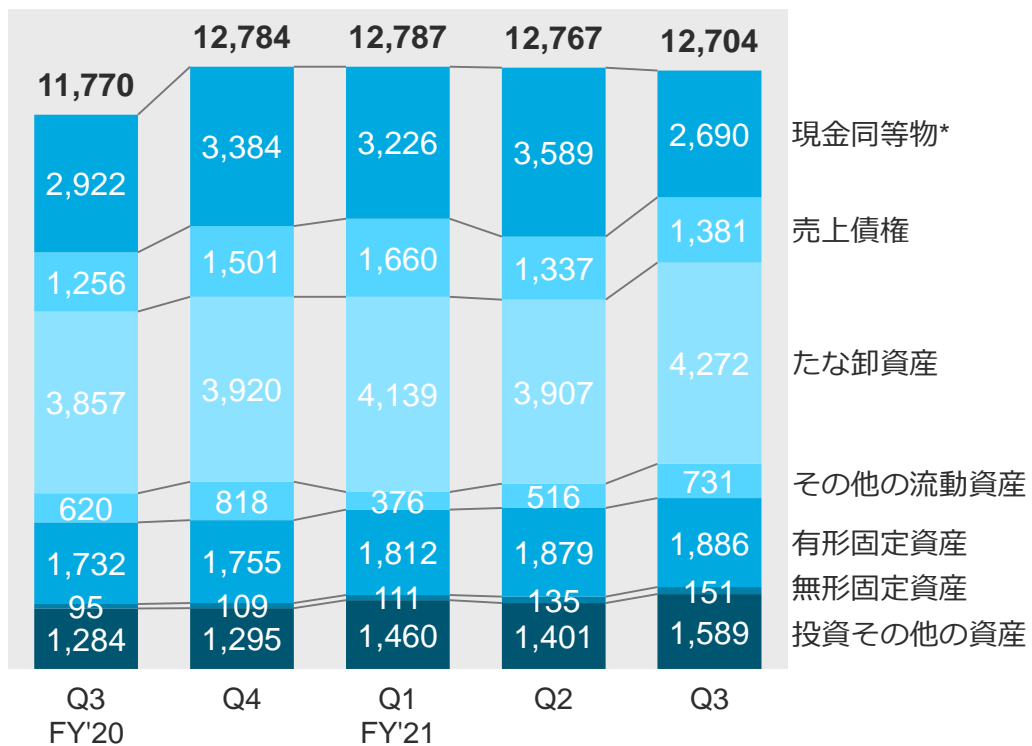


	Q3 FY'19	Q4 FY'19	Q1 FY'20	Q2 FY'20	Q3 FY'20	Q4 FY'20	Q1 FY'21	Q2 FY'21	Q3 FY'21
SPE売上高	696	742	674	734	722	826	818	791	906
FPD売上高	28	21	21	23	23	20	18	26	28

# 貸借対照表

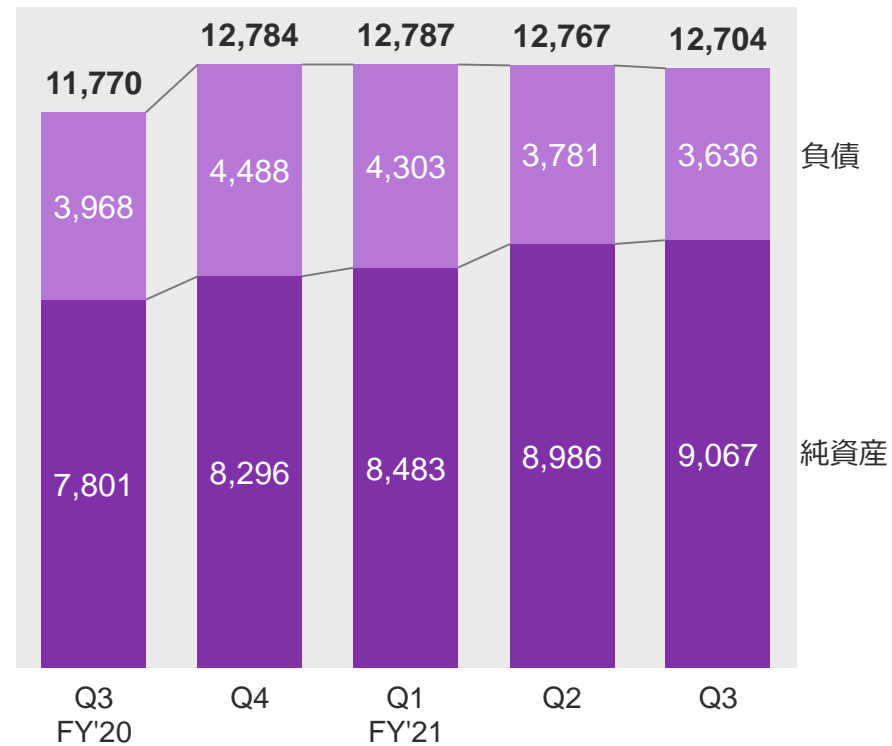
## 資産

(億円)

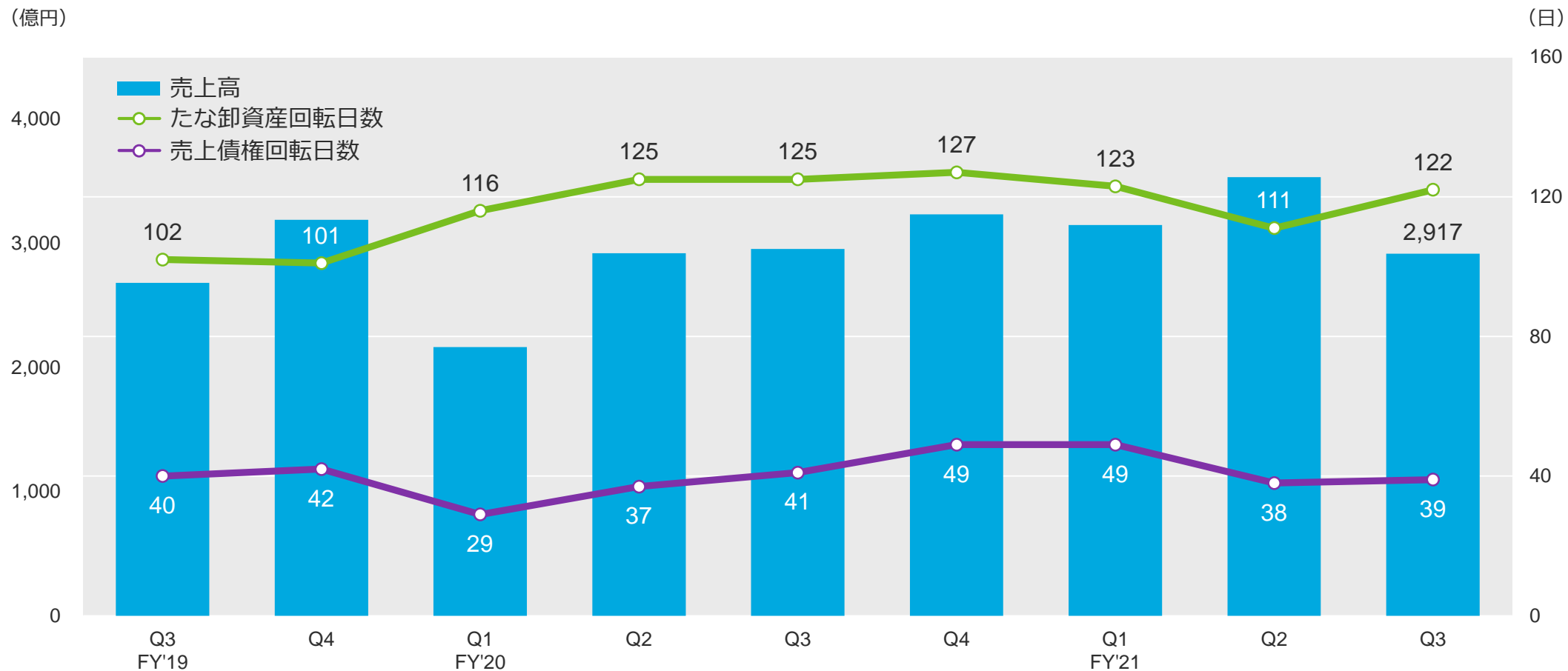


## 負債・純資産

(億円)

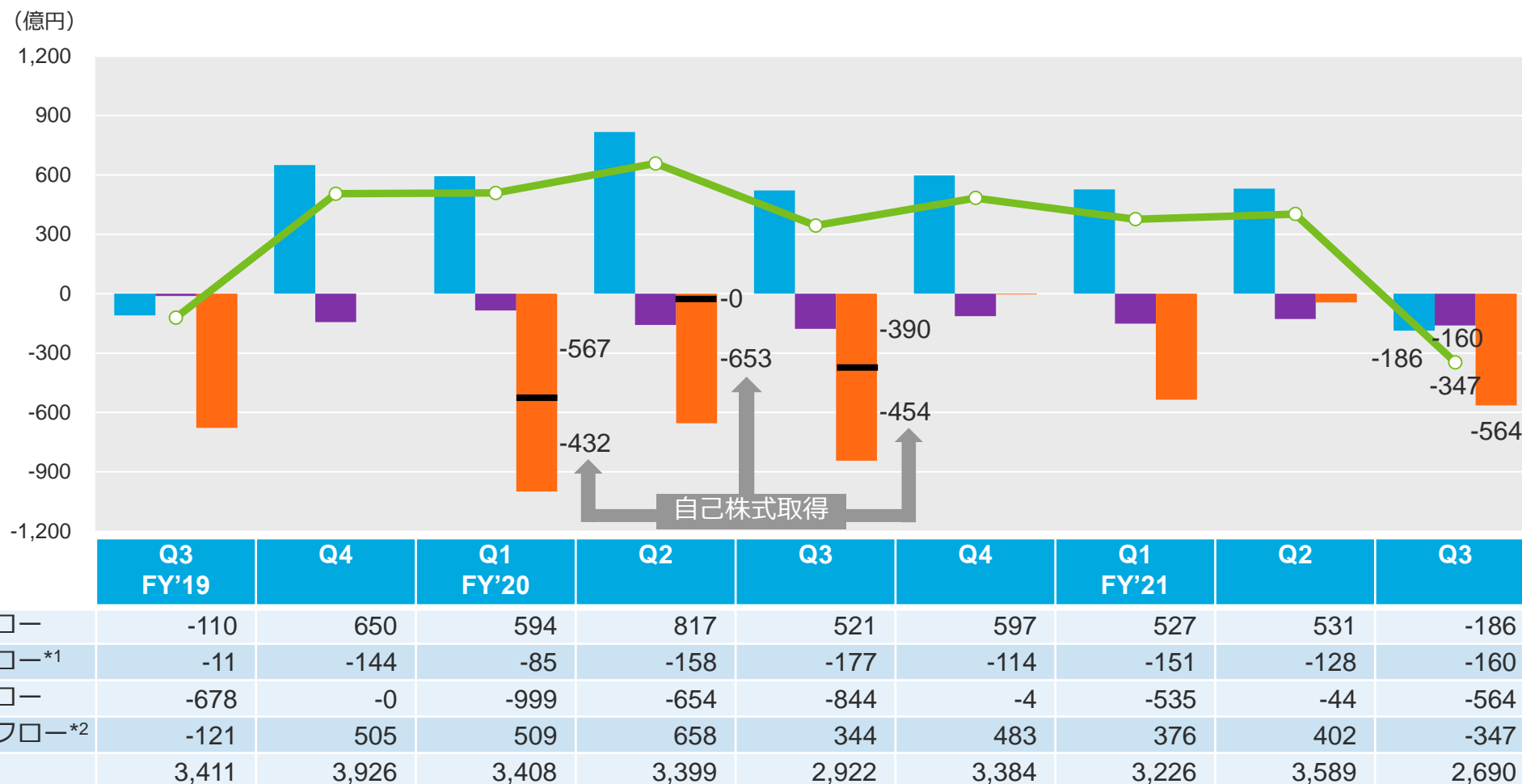


# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12カ月月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー



\*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

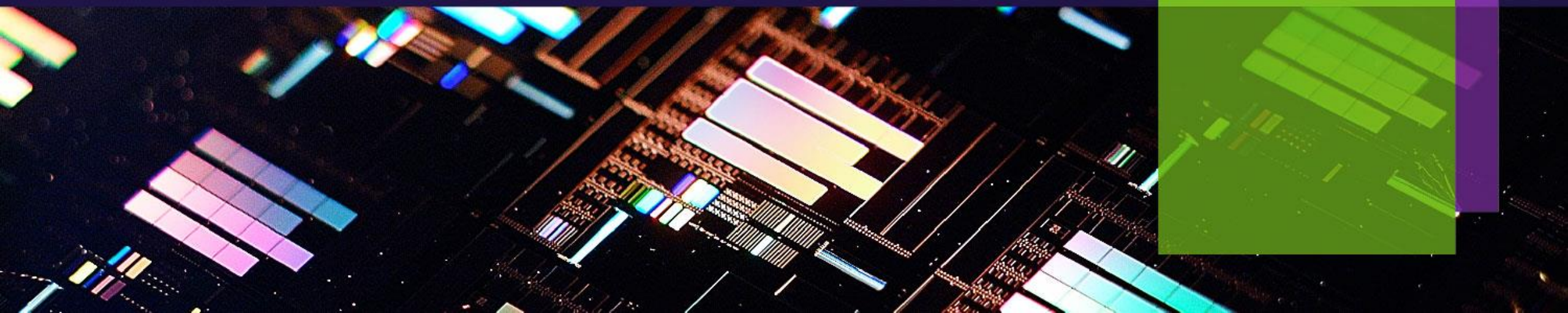
\*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

\*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

# 事業環境および業績予想

2021年1月28日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



## CY2021 事業環境（2021年1月時点での見方）

### ▶ 半導体前工程製造装置(WFE)\*1の設備投資

旺盛なロジック/ファウンドリ投資に加え、5Gモバイルの普及とデータセンター向けメモリ投資の回復に牽引され、現況では、CY2021の市場成長率は前年比20%増に迫る勢い

### ▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程\*2向け設備投資

モバイル向けOLED投資は前年比で増加も、大型パネル向けLCD投資は一巡。今後、OLED投資に牽引され市場の成長が期待できるが、CY2021は大型パネル向け投資がLCDからOLEDに移行する端境期として、前年比30%程度の減少を見込む

\*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

\*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

# CY2021 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

## ■ ロジック/ファウンドリ

- 市場環境： 情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が一層進み、市場成長を牽引
- 事業機会： 難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

## ■ DRAM

- 市場環境： 5Gモバイル、PC、データセンターの需要の増加に伴い、在庫調整が順調に進捗。一部前倒しを含め、年初より投資が回復
- 事業機会： 微細化に向けた新たな技術、新たな材料への対応

## ■ 不揮発性メモリ

- 市場環境： アプリケーションの拡大に伴い、前年同様の堅調な投資が継続
- 事業機会： 高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化



## FY2021 Q3における事業進捗

データ社会への移行に伴い、WFE市場は新たな拡大フェーズへ。  
当社の成長ポテンシャルを最大限に取り込むため、

- 新製品、新プラットフォームをリリース
  - 超臨界乾燥技術を搭載した洗浄装置CELLESTA™ SCD
  - エッチング装置向け、世界最高水準の高生産性プラットフォームEpisode™ UL



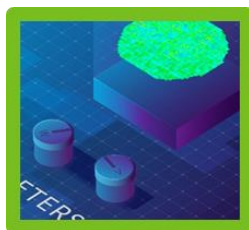
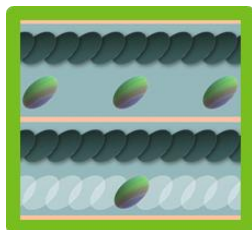
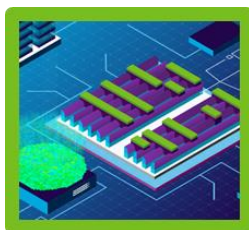
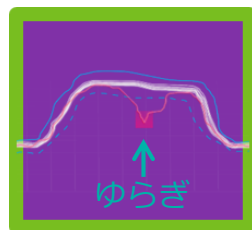
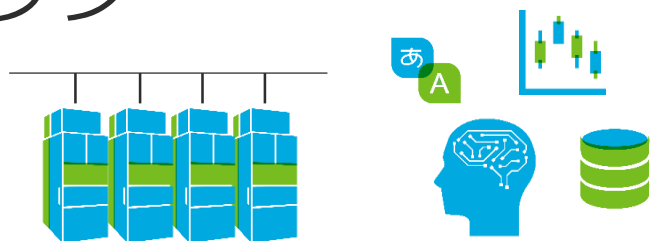
CELLESTA™ SCD



Episode™ UL

# FY2021 Q3における事業進捗

- DX（デジタルトランスフォーメーション）活動を強化。ソフトウェア開発拠点の札幌オフィスを移転し、TEL デジタル デザイン スクエアをオープン



機差・経時変化

プロセス間最適化

モジュール最適化  
・スマート Fab

Grand Opening  
**November 24, 2020**  
Proudly celebrating 30 years  
in Sapporo, Hokkaido, Japan



## FY2021 Q3における事業進捗

- 工場の生産キャパシティを増強。需要の増加に備えた生産体制を構築

新生産棟 稼動開始

(成膜・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム・FPDエッチング装置)

東北工場 2020年7月



山梨工場 2020年8月



半導体・FPD製造装置メーカーとして

基本理念

最先端の技術と確かなサービスで、  
夢のある社会の発展に貢献します

ICT（情報通信技術）が強力に実装されていく中、3つの観点で低消費電力化に貢献

- ① お客様の低消費電力半導体の技術開発に装置技術で貢献
- ② 装置メーカーとして当社製品の生産性向上と稼働時の省エネルギー化
- ③ 当社の事業活動における省エネルギー化

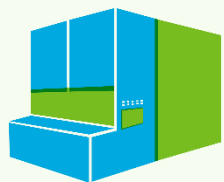


## 中期環境目標

- サステナブルな社会の発展に貢献するため、2030年に向けた中期環境目標を改定

### CO<sub>2</sub>排出量 削減目標

#### 製品



**30%** 削減

ウェーハ1枚当たり (2018年比)

注記：当社のバリューチェーンにおけるCO<sub>2</sub>排出量は、出荷済み装置の使用時が全体の約87%を占める

#### 事業所



**70%** 削減

総排出量 (2018年比)

各事業所のエネルギー使用量を  
毎年1%削減  
(原単位、年次目標、前年度比)

再生可能エネルギーの  
使用比率を100%に

# FY2021 業績予想

# FY2021 業績予想修正

(億円)

	FY2020 (実績)	FY2021 (予想)					通期 対前年増減
		H1	H2	通期			
		実績	新予想	新予想	修正額*		
売上高	11,272	6,681	6,918	13,600	+600	+20.6%	
SPE	10,609	6,354	6,445	12,800	+600	+20.6%	
FPD	660	326	474	800	0	+21.0%	
売上総利益	4,519	2,648	2,841	5,490	+260	+970	
下段：売上総利益率	40.1%	39.6%	41.1%	40.4%	+0.2pts	+0.3pts	
販管費	2,146	1,173	1,256	2,430	+10	+283	
営業利益	2,372	1,474	1,585	3,060	+250	+687	
下段：営業利益率	21.0%	22.1%	22.9%	22.5%	+0.9pts	+1.5pts	
税金等調整前当期純利益	2,446	1,477	1,583	3,060	+250	+613	
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,852	1,120	1,180	2,300	+200	+447	
1株当たり当期純利益 (円)	1,170.57	720.29	-	1,479.06	+128.49	+308.49	

当社が展開する装置の需要増加を反映し、通期業績予想を上方修正

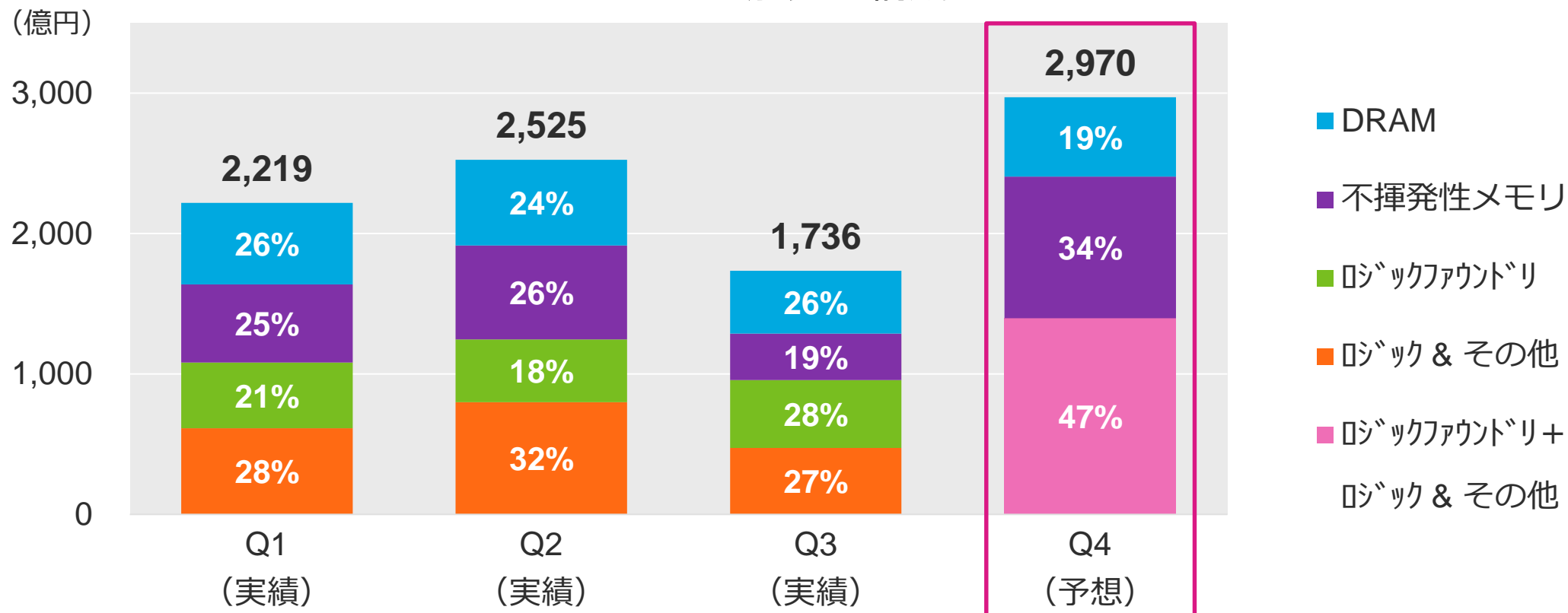
\* 修正額：2020年10月29日に発表した業績予想からの修正額を示しています。

SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置



# FY2021 Q4 SPE部門 新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



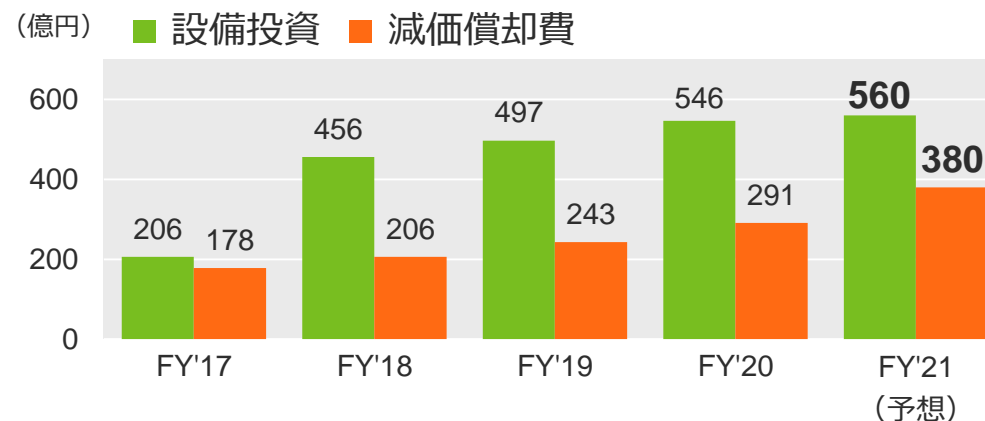
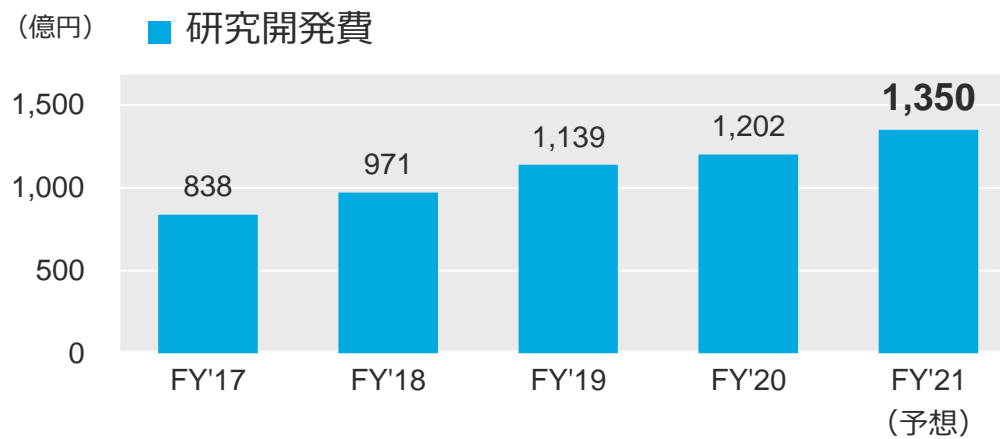
ロジック/ファウンドリおよびメモリの需要拡大に伴い、  
Q4は四半期売上として過去最高となる見込み

# FY2021 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,350億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 380億円

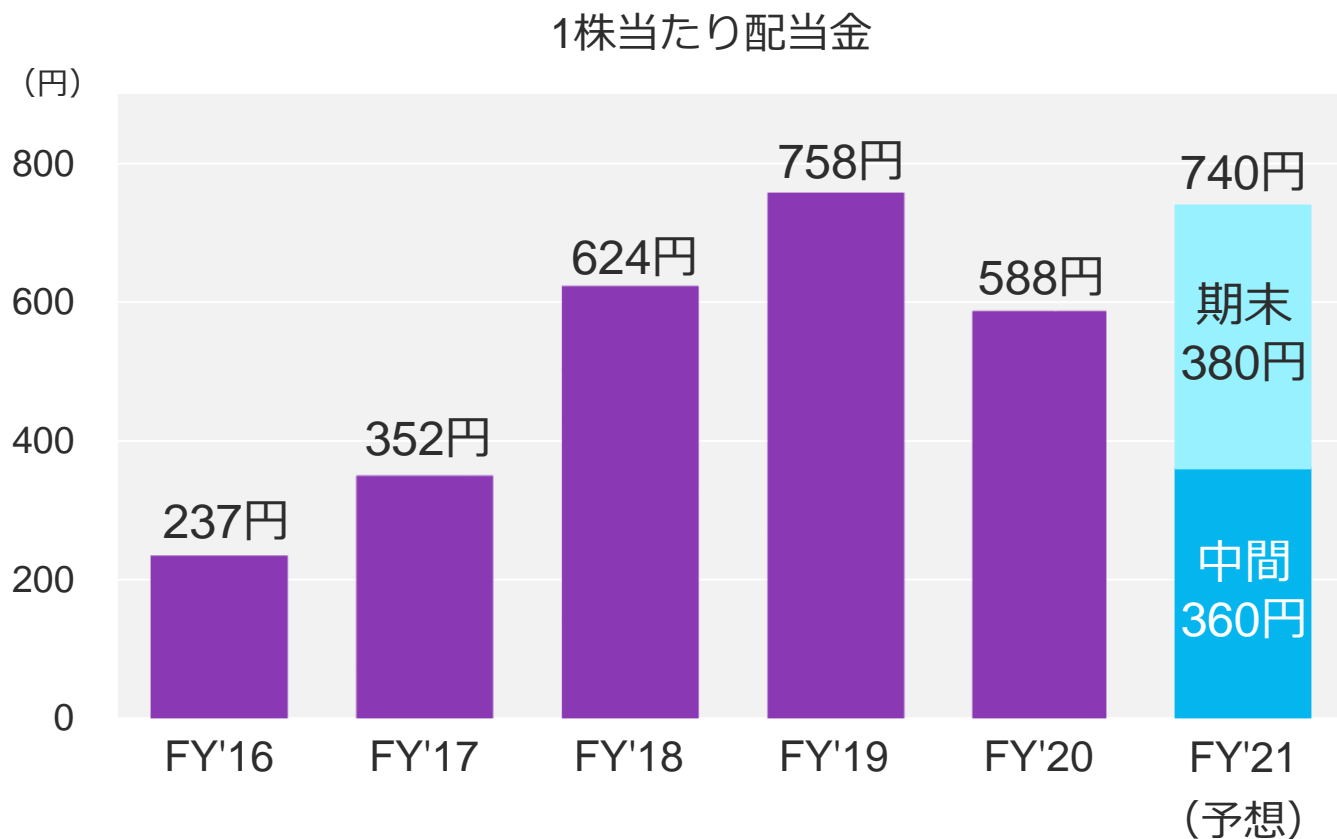


宮城技術革新センター  
(エッチング装置)  
宮城県黒川郡：建設費約70億円  
(2021年9月 竣工予定)



将来の着実な成長を実現するため、過去最高の  
研究開発投資および設備投資を見込む

# FY2021 配当予想



## 当社の株主還元策

**連結配当性向： 50%**

**但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない**

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

**自己株式の取得： 機動的に実施を検討**

1株当たりの配当金は、配当性向 50%に沿って740円を予定

**TEL**™

**TOKYO ELECTRON**